



具更換警示之 CMP 研磨定位環開發計畫

禾鐸實業有限公司

成立時間：民國96年1月10日

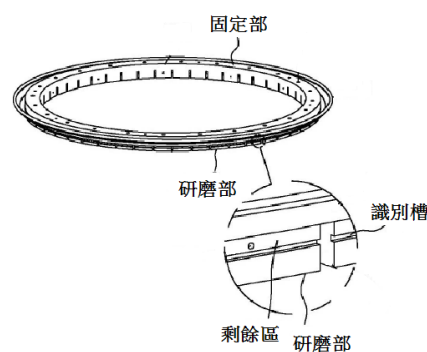
計畫聯絡人：翁嘉禧

主要產品：面板載具及半導體金屬耗材

公司網址：<http://www.nivek.com.tw>

計畫創新重點

本計畫之晶圓研磨定位環設計重點主要係在研磨部之環外側緣設計一識別槽，以能夠輕易警示及區隔研磨部之剩餘區，可以提供安全之隔離效果。當該研磨部使用磨耗接近該識別槽，即能夠直接透過目視即可知悉應更換新品之時機，且以更為明顯之段差顯示區隔性，以達到晶圓研磨之研磨品質控制之效果者。



研磨定位環結構剖面圖

計畫介紹

目前常用的研磨定位環使用一段時間後，其下部會漸漸磨耗，常常發現研磨完成的晶圓研磨品質不良時，才發現需要更換定位環，但已經產生不少不良品出現，造成相當多的損失。有鑒於此，目前市場尚無任何指示磨耗至何種情況應予更換新品，因此讓本公司萌生透過後加工法製作出一款與市面上相同產品卻有額外附加價值的產品，希望可為公司帶來更大的收益。

市場效益

配合國內外高科技產品殷切需求，採取主動推廣策略，向現有使用者介紹新產品，提升產品品質，並加強參與國際性雜誌及展覽，每年平均海外參展1次以上，發揚台灣製造業典範。重要製程及核心技術皆為本公司自行研發，且價格比市售產品便宜70%，因此預估三年內在台灣、中國將會有 6,000 萬元以上的產值。

公司簡介

禾鐸實業專營航太精密零件加工領域，光電面板載具，半導體金屬耗材，電子設備金屬精密零件開發設計及製作，為因應業務量之成長及提升品質與市場競爭力，自97年8月全力推行ISO 9001品保系統，於同年12月通過BSI獲得ISO 9001認證，又於106年通過航太AS 9100認證。

成果效益

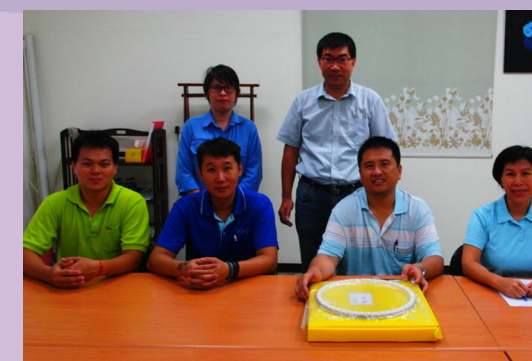
- 本案產品開發完成後，為因應後續行銷及量產，增聘作業員2名。
- 本產品成果申請專利1件〈晶圓研磨製程之研磨定位環〉。
- 成功銷售1筆訂單，訂單金額達60萬元。



本計畫之加工製作完成產品

創新 / 研發心得

本計畫之作業流程仍有諸多應改善之處，感謝審查委員耐心指導及建議，親切的態度以及不厭其煩解決開發中所遇到的問題，使參與此案人員都因透過分工合作為公司產出此新產品，而至產品開始上市之成就感，讓人對於公司凝聚力更為堅固。我司更了解唯有不斷創新，加上政府支持，根留台灣不再只是口號。



公司負責人 - 孫建忠 (右二) 與研發團隊合照